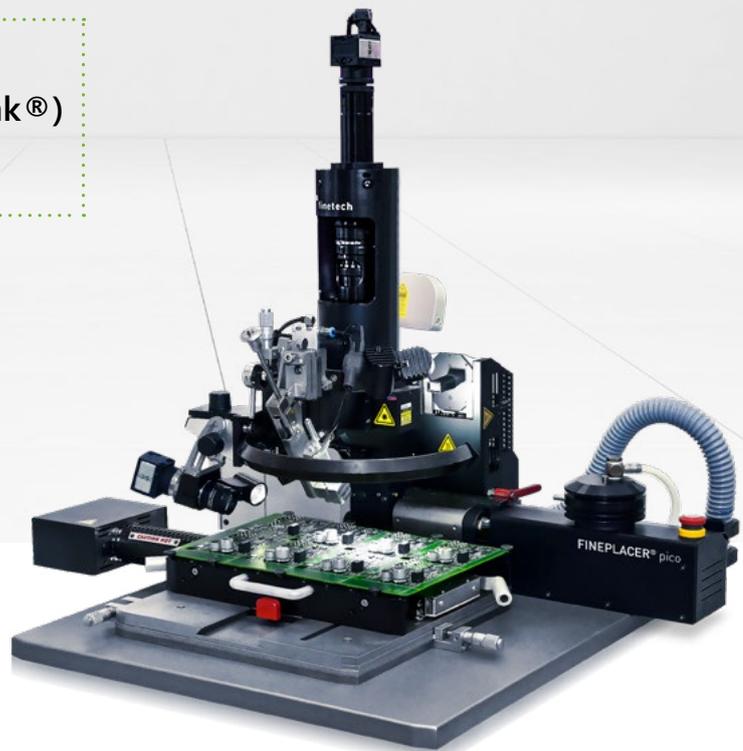


FINEPLACER® pico rs

ホットエア- SMDリワークステーション

高精度、多様性アドバンスドワーク

- ▶▶ 幅広いコンポーネント供給法
(wafer, waffle pack, Gel-Pak®)
- ▶▶ ホットエア-対応リワーク装置



実装精度5 μ m以下

独自のFINEPLACER® シリーズの原理

業界トップクラスの熱処理方法を提供

極めて優れた光学分解能

実行中プロセスの観察

データ及びメディアでの記録機能とレポート
管理機能

特長

固定式ビームスプリッターによるオーバーレイビジョンアライメントシステム(VAS)

3色LED照明

全プロセスへのアクセスと容易なプログラミング

パラメータに関連付いた全てのプロセスの同期制御

トップヒーターはソフトウェア制御校正機能有り

モジュールシステムの採用により装置導入後に各種モジュールの追加が可能

プロセスモジュールによる個別構成

フルオート及びセミオート機種への対応

微細な荷重制御による部品の取り扱い

利点

チップと基板の高精度ビジュアルアライメント

異なる素材に対する優れたコントラスト / 優れた可視性と画像認識による

プロセスシーケンスの高速構築と直感的なプロセス実装

最大限のプロセス管理と再現性

確実なリフロープロファイルによる高い生産性を実現します。プロファイルは装置間で共有化されプロセスの結果を保証します。

新しいアプリケーションと技術の要求に即時に簡易に適合します。

アプリケーション要件に合わせたオーダーメイドのソリューション

お客様のアプリケーション要求に応じたリワーク装置を提供。

微小デバイス、繊細なデバイスを安全にハンドリング (008004等)

実装方式

- » 表面実装技術 (SMT)
- » スルーホール技術 (THT)
- » ピン in ペースト (PiP)

対応プロセス

- » コンポーネントリムーブ/デソルダリング
- » 非接触サイトクリーニング/ソルダーリムーブ
- » リボール/ シングルボール/リボール
- » ペーストプリント (コンポーネント/PCB)
- » ディピンング
- » デイスペンディング
- » ソルダリング

アプリケーション

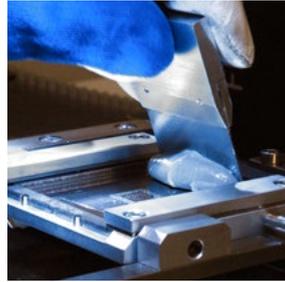
- » BGA, CSP, QFN, DFN, QFP, PGA, SOT など
- » 微小BGA、微小チップ
- » 小型パッシブコンポーネント (008004まで)
- » LED、Mini LEDアレー
- » パッケージ on パッケージ (PoP)
- » ドーターボードサブ基板
- » RF シールド、RF フレーム
- » コネクターソケット
- » アンダーフィルコーティングコンポーネント
- » FR4リワークフレックス基板、ガラスセラミクスアルミキャリア

モジュール及びオプション

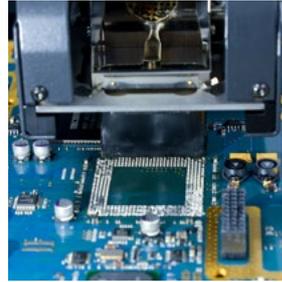
- » バーコードリーダー(SmartIdent)
- » チップ加熱モジュール
- » コンポーネント供給
- » ダイレクトコンポーネントプリントモジュール
- » デイスペンサーモジュール
- » ホットガス ボトムヒーティングモジュール
- » デッピング/スタンピングモジュール
- » PCBサポート
- » プロセスガス切替モジュール
- » プロセススタートセンサー
- » プロセスビデオモジュール
- » リポールモジュール
- » RGW - Illumination
- » ハンダ除去モジュール
- » 分割視野光学系
- » 基板加熱モジュール
- » 基板サポート
- » ターゲットファインダー
- » 上側加熱モジュール(加熱ガス)
- » Zoom-Optics^{plus}



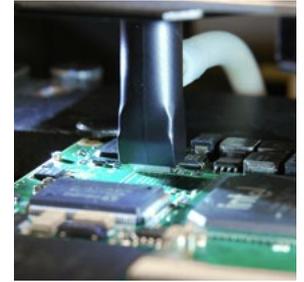
プロセスビデオモジュール



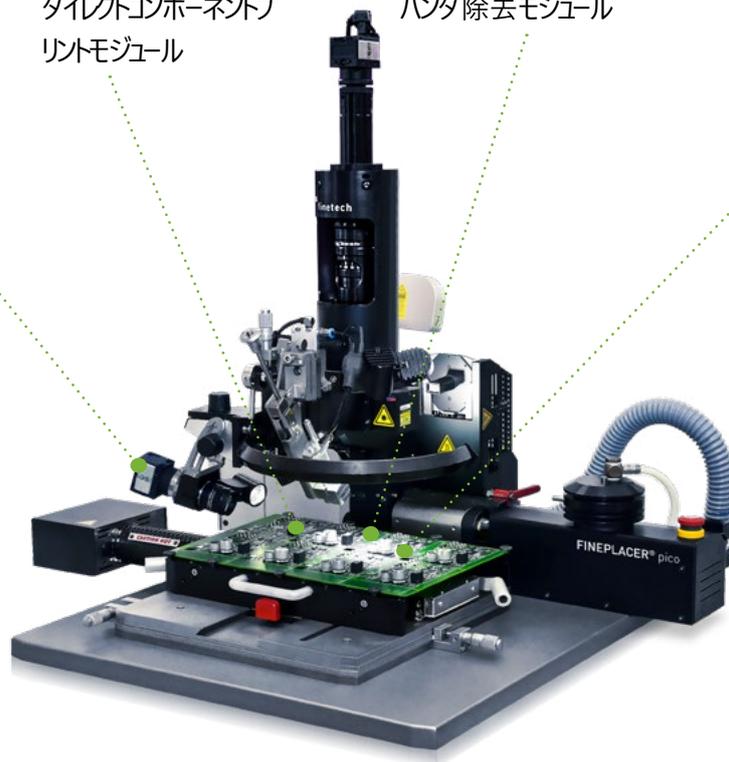
ダイレクトコンポーネントプリントモジュール



ハンダ除去モジュール



上側加熱モジュール(加熱ガス)



Accuracy

5 μ m

Component

min. 0.100 mm x 0.100 mm
max. 50 mm x 50 mm

Board Size

350 mm x 234 mm

Operation

manual semi automatic automatic

モジュール化の効果

FINEPLACER®には数多くのプロセスモジュールや機能モジュールが用意されているため、非常に幅広い用途に対応することが可能です。この柔軟性により、初期段階ではその時点のニーズに適合した構成が選択可能です。さらに私たちのシステムには、その耐用年数全体にわたって新しいタスクに追加対応することができます。これが我々の装置の重要なコンセプトの一つです。モジュールは容易に組み合わせたり交換したりできるため、システムの柔軟性が高まり、長期的に投資を無駄にせずに済みます。



どのワークシステムが要件に適するか

OEM企業やEMSサービスプロバイダーの生産管理者やプロジェクト管理者の方は、プロフェッショナルなSMDワークシステムの選択に直面しているのではないのでしょうか？ ニーズに合ったソリューションを見つけるためには、まず確認すべきいくつかの質問があります。市場に出回っているどのタイプのワークシステムが、自社の生産やプロジェクトの要件に最適なのか、事前に評価しておく必要があります。このチェックリストは、さまざまな業界でワークが行われているお客様と共同で作成されたもので、将来のシステムを選択するために考慮すべき事項をまとめたものです。

[資料のダウンロードはこちら:](#)



カスタマーフィードバック

"We have been partners with Finetech for over 20 years now and they have always been open to our needs. The support they provide is immeasurable – their engineering team is very accessible and everyone is well connected and deeply involved with each project. The quality we get is always at the highest level – from the first to the 2,000th board."



Nafi Pajaziti
CEO, BMK Electronic Services